

● **WLP-5-08 パッケージ許容損失(JESD51-7)**

WLP-5-08 パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1. 測定条件(参考データ)

測定条件：基板実装状態

雰囲気：自然対流

実装：Pb フリーはんだ

実装基盤：4層基板 76.2mm×114.3mm (片面約 8700mm²)

に対して銅箔面積

1層目*：銅箔無し (信号層の為)

2層目：70mm×70mm (放熱板と接続有)

3層目：70mm×70mm (放熱板と接続有)

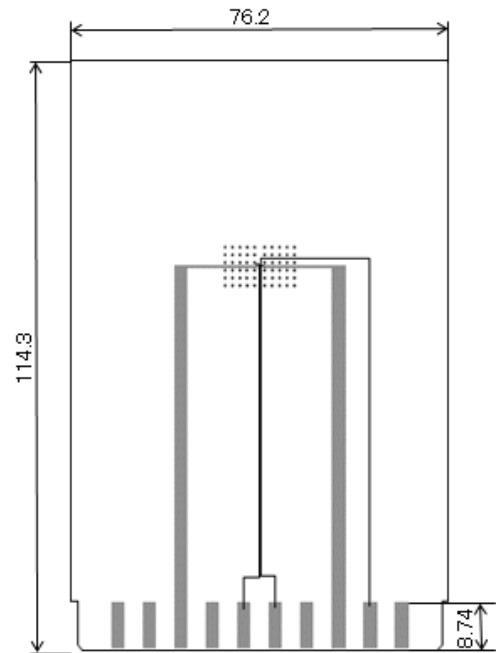
4層目：銅箔無し (信号層の為)

基板材質：ガラスエポキシ (FR-4)

板厚：1.6mm

スルーホール：φ0.2mm 60個

*信号層のパターンの影響から、銅箔厚は35μmとしています。



評価基板レイアウト(単位:mm)

2. 許容損失-周囲温度特性

基板実装 (Tjmax=125°C)

周囲温度 (°C)	許容損失 Pd (mW)	抵抗値 (°C/W)
25	500	200.00
105	100	

